

# 営業の概況

## 半導体製造装置部門

PC、携帯電話などネットワーク・モバイル関連機器に使われる半導体チップ及びLCDパネルの需要が1999年後半から急増し、2000年の世界の半導体・LCD設備投資は大きく拡大しました。それに伴い、当社の半導体製造装置部門の連結受注高も、前期比20.6%増の6,276億円と大きく増加しました。

このような状況のなかで、急務となった生産能力の増強を敏速に行った結果、当期の半導体製造装置部門の連結売上高は、過去最高を大幅に更新する前期比74.3%増の6,190億円となりました。当期の連結売上高に占める部門比率は前期の80.6%から85.5%へと上昇しました。

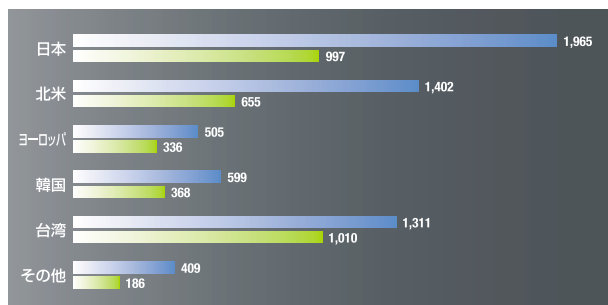
なお、2000年後半には、半導体の在庫調整、米国経済の成長の鈍化などが市場に影を落とし始め、2001年の初頭から世界的に半導体設備投資が縮小し始めました。この影響で当社の受注の低迷も年明け以降鮮明となりましたが、高い受注残に支えられて当期収益への影響はありませんでした。

### 地域別概況

東京エレクトロンが事業を展開するすべての地域の売上高が、前期比大幅増となりました。前期、売上規模で初めて首位の座を台湾に明け渡した日本国内の売上高は、当期97.2%増の1,965億円と大きく伸長し、地域別売上構

半導体製造装置部門地域別売上高

(単位:億円)



■ 2001年 3月期  
■ 2000年 3月期

注: 日本の売上には他社製輸入品の売上が含まれています。

成比で31.7%と、最大地域に復活しました。売上高で特に大きい伸びを示したのは米国でした。前期の2倍を超える1,402億円となり、あらためて米国での当社装置のシェアが上昇していることが確認されました。台湾での売上高は前期比29.9%増の1,311億円となりました。他の地域に比べて低い伸びにとどまったのは、台湾の半導体ファウンドリ(受託生産会社)が他の地域に先行しすでに前年に設備投資を拡大していたためです。欧州は50.4%増の505億円、韓国は62.7%増の599億円、その他地域は120.0%増の409億円となり、ともに大きく売上高を伸ばしました。

### 製品別概況

当期、すべての製品カテゴリーの売上高が、前期に比べ大幅増となりました。特に増収に大きく貢献したのはCLEAN TRACK ACT®シリーズを主力とするコータ/デベロッパとUNITY®シリーズを主力とする酸化膜エッチング装置でした。これらは世界市場ですでに大きなシェアを誇る製品ですが、当期も市場の伸びを上回る成長を示し、さらなるシェアの拡大を実現しました。

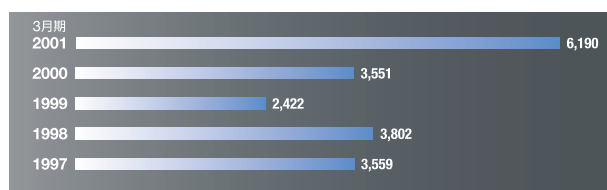
当期の半導体設備投資の特徴の一つは、DRAMメーカーやFLASHメモリーメーカーが新しい生産ラインの構築を再開したことでした。こうした環境の恩恵をダイレクトに受けるシリーズの酸化/拡散・LP-CVD装置の売上高

注: 本アニュアルレポートに記載された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

は、3期ぶりに過去最高を更新しました。現在当社では、システムLSIなど、少量多品種生産の高付加価値半導体向けに、スモールバッチ、連続プロセス処理で早い製造サイクルタイムを実現する新高速熱処理炉TELFORMULA™の開発を進めています。

トランジスタ工程( FEOL )の成膜に強みを持つ枚葉CVD装置MB<sup>2</sup> - 730, UNITY®シリーズの売上高も前期比大幅増となりました。このトランジスタ工程( FEOL )での強みを維持しつつ、今後は、大きな成長が見込める多層配線工程( BEOL )へのアプリケーションの拡大を図っていきます。

半導体製造装置部門売上高 (単位: 億円)



洗浄システム、ウェーハプローバの売上高も前期比大幅増となりました。洗浄システムは、多層配線工程( BEOL )における洗浄を行なう新製品PR-200Zが好調に伸びて、当期の増収の大きな要因となりました。この製品の投入が市場シェア上昇の引き金となり、当期、当社は世界第2位の洗浄装置メーカーに躍進しました。ウェーハプローバにおいても、高精度位

置合わせ、高耐荷重ステージを擁する300ミリウェーハ対応モデルP-12XLの受注が好調にスタートしており、300ミリ市場におけるリーディングポジションを築きつつあります。

多層配線工程( BEOL )において層間絶縁膜を塗布形成する CLEAN TRACK ACT®シリーズのSODコートは市場に投入してまだ間もない製品ですが、世界の多くの主要半導体メーカーの最先端R&Dラインへの導入が済み、性能評価が開始されています。

LCD製造装置の売上高は、前期比68.3%増の718億円となり、2年連続で過去最高を更新しました。近年、製造される基板サイズは大きくなる傾向にあります。

当期、当社はウェーハの300ミリ化で先行する半導体メーカー数社に対して300ミリ装置の出荷を開始しました。

## 米国Supercritical Systems社とTimbre Technologies社の買収

当期、新規技術の獲得を目的に、米国の革新的な技術を持つ2社を買収しました。2000年10月に買収したSupercritical Systems社は、デザインルール100ナノメートル( 0.1ミクロン )以下で有望となる超臨界洗浄技術を有しています。2001年2月に買収したTimbre Technologies社は、今後重要となる半導体製造ラインでの最先端プロセス制御技術( アドバンスプロセスコントロール = APC )を実現するための計測用ソフトウェア技術( Optical Data Profilometry )を持っています。この技術を当社製品に搭載することで、高い付加価値を持つ装置群の構築を図っていきます。

## 米国NuTool社とのパートナーシップ

2000年10月、銅配線用メッキ装置のサプライヤーである米国NuTool社とパートナーシップを結び、同装置の東南アジアの一部地域を除く全世界におけるマーケティング、販売およびサービスサポートを開始しました。同社のNuTool™ 2000は、独自の機構により下地のアスペクト比やパターンの粗密にかかわらず、ウェーハ上に銅膜を平坦にメッキする革新的な性能を持つ装置です。当社のグローバルに広がる販売・サービス網と、創業以来培ったディストリビューションビジネスのノウハウが最大限に生かせる新しいビジネスモデルが誕生しました。当社は今後も他の優れた装置サプライヤーとのアライアンスを柔軟に視野に捉えていきます。

## コンピュータ・ネットワーク部門



F5 Networks, Inc.  
 • Server Load Balancer  
 nCipher Corporation plc.  
 • Hardware Security Module  
 • SSL Accelerator  
 LuxN, Inc.  
 • DWDM Equipment  
 Sony Corp.  
 • High Performance Tape Library

コンピュータ・ネットワーク部門の連結売上高は、前期に引き続きインターネット・ビジネスの基盤となるIT関連機器の売上が順調に伸び、前期比13.7%増の141億円となりました。その中でも特に顕著な伸びを見せたのが、ネットワーク関連製品とSAN(Storage Area Network)関連製品でした。

ネットワーク関連製品では、Extreme Networks社のGigabit ETHERNETスイッチが前期比1.7倍と堅調に売上を伸ばしたほか、インターネット・ビジネス・サイトの拡大にともなってF5 Networks社のサーバ負荷分散装置が急激な成長を遂げました。また、電子署名法が施行されるなどセキュリティの重要性も本格的に認識され始め、前期に取引を開始したnCipher社のセキュリティ製品が、当期後半には急速に売上を伸ばしました。

ネットワークのブロードバンド化が進むなか、ますます大容量化するデータのストレージに対する関心も非常に

コンピュータ・ネットワーク部門売上高

(単位:億円)



高まりました。インターネット・データ・センター(iDC)ビジネスの本格化も手伝い、SAN構築のかなめとなるBrocade社のファイバーチャネル・スイッチは、売上が前期比5.3倍と拡大しました。また、データ量の増大にともなってデータ管理の重要性も高まり、VERITAS社のSAN管理ソフトウェア及びソニー(株)のテープ装置も順調に売上を伸ばしました。

当部門は、時代のニーズに対応した商品を提供することはもちろん、常にIT分野の最先端技術をマーケティングしています。LuxN社のDWDM(高密度波長分割多重)装置は、ブロードバンドを促進する技術として注目し、当期より取引を開始しました。また、最先端製品のサポート・サービスで培った技術力を生かし、当社オリジナルのシステムも開発・販売しています。Ruff Systems™は高品位画像を非圧縮で配信できるシステムで、放送関連や医療機関といった新しい分野でも注目され始めています。

今後も引き続きインターネット・テクノロジーおよびSANをコア分野と位置づけ、次世代のポータルとなる商品を開拓していきます。

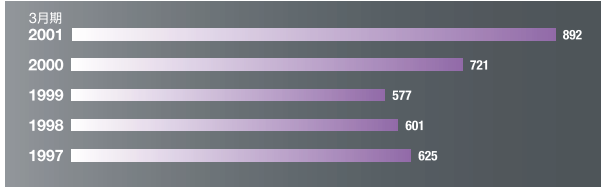
注: 1. 2000年4月1日より、コンピュータ・システム部門はコンピュータ・ネットワーク部門に名称を変更しました。

2. 本アニュアルレポートに記載された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

## 電子部品部門

電子部品部門売上高

(単位:億円)



電子部品部門の当期連結売上高は、前期比23.8%増加の892億円となり、2年連続で過去最高を更新しました。移動体通信・インターネット接続機器などの通信関連機器、次世代携帯電話向け基地局のインフラ整備にともなう設備投資、DVD、カーナビゲーションシステムなどのデジタルコンシューマ機器といった成長分野にフォーカスし、技術サポートを要する

高付加価値製品の販売を積極的に行ったことが成長の大きな要因となりました。

売上の87%を占める半導体製品の売上においては、PLD(プログラマブルロジックデバイス)を主力とするセミカスタムIC、通信関連分野の特定用途向けIC、および移動体通信向けフラッシュメモリ等の各種ICがそれぞれ大幅に伸長しました。特にセミカスタムICの伸びが著しく、Xilinx社製品の売上高は前期比2倍以上となりました。

過去3年以内に取り扱いを開始した新規プロダクトラインの売上は、前期比2倍以上と大きく伸長し、これらが売上高全体に占める割合も10%に拡大しました。特にPixelworks社の画像処理用ICの売上高は前期比4倍近くに達しました。当期も、成長市場である情報通信関連市場やデジタルコンシューマ市場において製品開発力のあるサプライヤーと新規に代理店契約を交わし、取り扱い商品の新陳代謝を図っています。

また、当部門では、蓄積された豊富な経験を生かし、お客さまのニーズに合わせたLSIの設計受託や、独自の設計・開発によるオリジナル製品を提供しています。当期、ASICならびにPLDの設計受託が伸びましたが、今後これらの需要の拡大が続くと予想されるため、これに対応するための設計開発体制の再編・拡充を推進しています。オリジナル製品の開発強化、技術サポートの一層の充実と合わせ、技術商社としての基盤確立に努めています。

また、新商品開拓のためのマーケティング機能の拡充を図り、顧客指向の営業展開をより一層強化するため、コーポレートマーケティンググループの新設や営業推進グループの再編などの組織改革を行いました。営業部門のモバイルコンピューティング化、二次商社とのB to BコマースなどのITを基盤とした業務改革にも着手し、経営の効率化を推進しています。



注：本アニュアルレポートに記載された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。